



A. Interconnect & Package 분과

2021년 1월 29일(금), 13:00-14:30 / 채널 C

[FC3-A] Advanced Package

좌장: 김병준 교수 (안동대학교), 최광성 박사 (ETRI)

<p>FC3-A-1 13:00-13:30</p>	<p>[초청] TSV Products Trend in Subscription Economy 이웅선 SK하이닉스</p>
<p>FC3-A-2 13:30-13:45</p>	<p>Micro Bump 에서의 Cu Plating Chemical 의 Bump 형상에 대한 연구 정성목, 손호영, 김성규, 윤성원, 안재용, 정진욱 SK 하이닉스</p>
<p>FC3-A-3 13:45-14:00</p>	<p>Fine Pitch Cu/SnAg Pillar Bump Interconnects on Nickel-less Electroless Palladium Immersion Gold (EPIG) Surface Finish Tae-Young Lee^{1,2}, Jungsoo Kim¹, So Yeon Jun¹, Young-Ho Kim², and Sehoon Yoo¹ ¹KITECH, ²Hanyang University</p>
<p>FC3-A-4 14:00-14:15</p>	<p>Development of Active Matrix (AM) Digital Signage Modules Using Laser-assisted Bonding (LAB) Technology Kwang-Seong Choi¹, Jiho Joo¹, Ki-seok Jang¹, Chanmi Lee¹, Yong-Sung Eom¹, Gwang-Mun Choi¹, Ho-Gyeong Yun¹, Seok Hwan Moon¹, Jong-Sun Kim², Mingyun Oh², Ji-Hoon Choi³, Ji-Woong Choi³, Sung-Yun, Cho³, and Sang-Ki Kim⁴ ¹ICT Creative Laboratory, ETRI, ²SiliconInside Co., Ltd., ³AQLASER Co., Ltd., ⁴HS Semicon</p>
<p>FC3-A-5 14:15-14:30</p>	<p>Ar/N₂ 플라즈마 조건에 따른 Cu-Cu 직접접합부의 미세조직 및 계면접착에너지 평가 및 분석 최성훈¹, 김가희¹, 서한결², 김사라은경², 박영배¹ ¹안동대학교 신소재공학부 청정에너지소재기술연구센터, ²서울과학기술대학교 나노 IT 디자인융합대학원</p>

1월 29일 (금)